

2013年4月17日
三菱電機株式会社

**GTWⅢシリーズをモデルチェンジし、生産性をさらに向上
三菱基板穴あけ用レーザー加工機「GTW4シリーズ」発売のお知らせ**

三菱電機株式会社は、基板穴あけ用レーザー加工機の新製品として、新開発のガルバノスキャナーおよび高出力レーザー発振器の搭載により生産性をより向上させた「GTW4シリーズ」を4月22日に発売します。

本製品は、「第43回国際電子回路産業展（JPCA Show2013）」（6月5日～7日、於：東京ビッグサイト）に出展します。



三菱基板穴あけ用レーザー加工機「ML605GTW4-5350U」

新製品の特長

1. 新開発ガルバノスキャナーと高出力レーザー発振器の搭載で、加工時間を短縮

- ・ガルバノスキャナー※1の位置決め速度を約20%高速化※2
- ・定格出力360Wと高出力化※3を実現した新型レーザー発振器「ML5350U」を搭載
- ・マザーボード基板における加工時間を約20%短縮し、生産性を向上※2
 - ※1 ミラーを高速で駆動し、レーザー光を位置決めする装置
 - ※2 従来機GTWⅢとの比較（加工内容、加工材料等によって異なります）
 - ※3 従来機レーザー発振器「ML5200U」における定格出力200Wとの比較

2. 加工可能範囲を拡大、大型サイズの基板にも対応

- ・「ML706GTW4-5350U」は、815×662mmサイズの基板まで加工範囲を拡大※4
- ※4 従来機ML706GTWⅢ（加工可能範囲：780×625mm）との比較

発売の概要

製品名	形名	希望小売価格(税抜き)※5	発売日	月産台数
基板穴あけ用 レーザー加工機	ML605GTW4-5350U	1億1400万円	4月22日	50台
	ML706GTW4-5350U	1億1700万円		

※5 基板搬送装置を除く、搭載レンズ・オプションにより異なります

報道関係からの
お問い合わせ先

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 TEL03-3218-2332 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部

発売の狙い

近年、スマートフォンやタブレット PC 等、電子機器のさらなる高機能化と小型化が進み、小型電子機器用のマザーボード基板や半導体パッケージ基板の製造においては、基板への微細穴あけ用途として、レーザー加工の需要が拡大しています。一方、レーザー加工機に対しては、基板製造工程のコストダウンを図るためにさらなる加工時間の短縮が求められています。

これらの要求に応えるために、当社は今回、新開発のガルバノスキャナーと高出力レーザー発振器の搭載により、生産性のさらなる向上を実現した、基板穴あけ用レーザー加工機「GTW4 シリーズ」を発売します。

主な仕様

項目		仕様		
システム	形名	ML605GTW4-5350U	ML706GTW4-5350U	
	外形寸法 (mm) ^{※6}	4520W×3370D× 2270H	4700W×3455D× 2270H	
	機器質量 (kg) ^{※6}	9000	9100	
加工機	XY テーブル	加工ワーク寸法 (mm)	620×560	815×662
		最大送り速度 (m/min)	50	50
発振器	レーザーの種類		CO ₂ レーザー	CO ₂ レーザー
	出力 (W)		360	360
	設定周波数 (Hz)		10～10000	10～10000

※6 加工機・発振器・制御装置・冷却装置・ワーク吸着装置・基板搬送装置(オプション)を含めた寸法・質量
基板搬送装置の仕様によって寸法・質量は異なります

製作担当工場

三菱電機株式会社 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目1番14号
TEL 052-721-2111 (代表) FAX 052-722-2181

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
TEL 03-3218-6560 FAX 03-3218-6822